

新製品

R-jet[®]

ツインエア一式 高精細ディスペンサー

Twin Pneumatic High-Resolution Liquid Dispensing System
with Top & Side View Optics

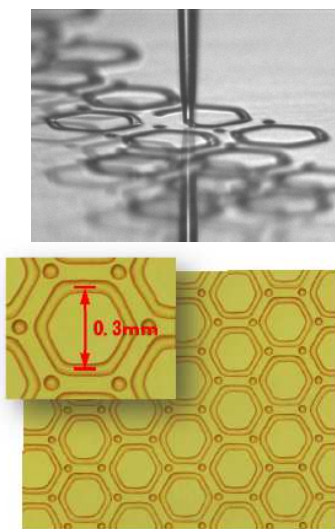
リアルタイム・トップ&サイドビュー光学系搭載

0201超小型電子部品製造工程……………各種接着剤の極微量塗布
微細パターンニング、スクリーン印刷の断線リペア……………銀ペースト
電極形成、キャビティ内部の局所配線……………水晶発振子、MEMS、LED等
LED製造工程の微量塗布……………蛍光粒子／酸化チタン液剤
ハンダリペア、ハンダグリッドアレイ形成……………微量ハンダペースト滴下
CMOS、CCD、PWRデバイス等……………封止材、絶縁材の微細な額縁塗布
微小レンズ、ガラス部品の遮光材塗布・絞り形成…カーボンブラックインク
ピエゾ式インク・ジェットや、既存のディスペンサーでお困りの方

小型軽量
量産工程へ最適



RHB 100C
ディスペンスユニット
(ベーシック・タイプ)



トップビュー搭載で
R&D、試作へも活用



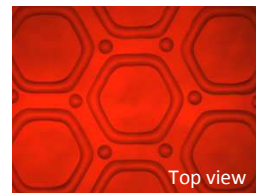
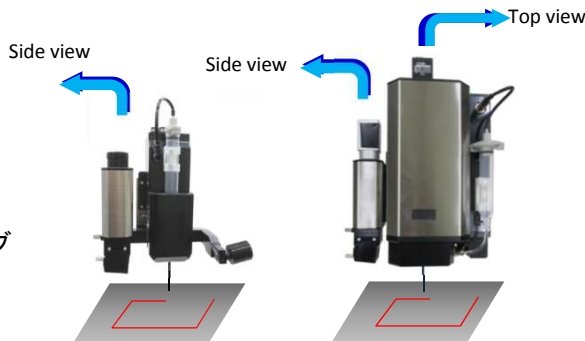
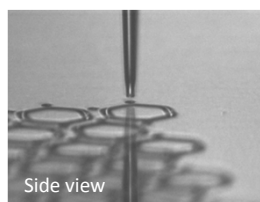
RHF 100C
ディスペンスユニット
(マルチファンクション・タイプ)

ドットとラインを一連動作で吐出可能
ダイナミック・ディスペンシング・モード・コントロール～DDMC

エスコエレクトロニクス株式会社



■リアルタイム・トップビュー&サイドビュー光学系（サイドビューはオプション）



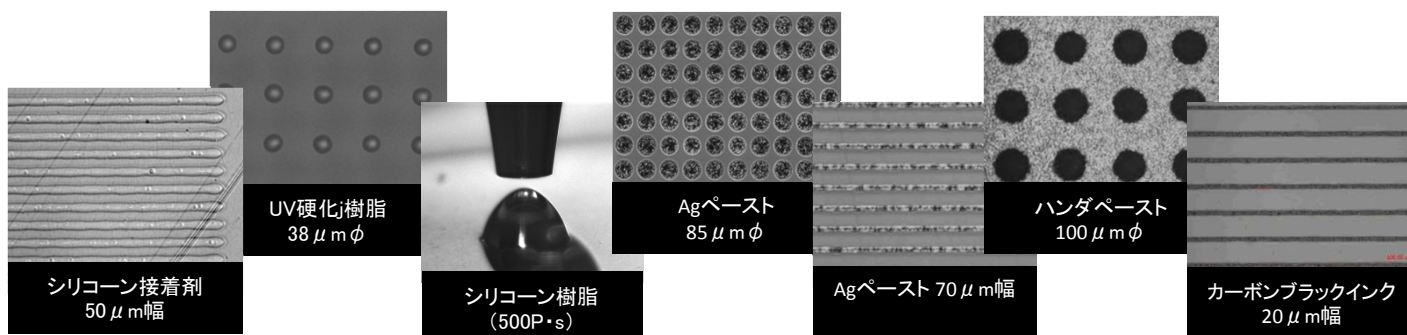
- 液流のリアルタイム・モニタリング
- 液流および着液状態の観察
- 基板の凹凸状態の確認
- ノズル先端とのギャップ確認

- オン・アクセス・アライメント
- 濡れのリアルタイム・モニタリング
- 塗布・描画後の簡易寸法測定
- 形状検査(要、画像処理ユニット)

ベーシック・タイプ

マルチファンクション・タイプ

■描画・塗布アプリケーション例



シリコン接着剤
50 μm幅

UV硬化樹脂
38 μmφ

シリコン樹脂
(500P・s)

Agペースト
85 μmφ

Agペースト 70 μm幅

ハンダペースト
100 μmφ

カーボンブラックインク
20 μm幅

仕様は予告なく変更することがあります。最新の仕様に関しましては弊社までお問い合わせください。

仕様(抜粋) / 型名	RHB100C ディスペンスユニット(ベーシック)	RHF100C ディスペンスユニット (マルチファンクション)	RDX500-V RHF100C搭載 デスクトップ・システム
トップビュー	搭載不可	標準搭載	←
サイドビュー	オプション	←	←
セラミックノズル(内径μm)	25,40,70,100,150,200	←	←
極微細ノズル(内径μm)	25μm未満のみ特注対応	←	←
レーザー変位計	搭載不可	オプション	←
トップビュー用カメラ	搭載不可	オプション	←
サイドビュー用カメラ	オプション	←	←
X-Y-Zステージ(ロボット)	なし(別途ご用意ください)	なし(別途ご用意ください)	X-Y軸50mm駆動、Z軸100mm駆動
外観			

エンジニアリングシステム株式会社

<http://www.engineeringsystem.co.jp>



〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83
TEL.0263-26-1212・FAX.0263-26-1213
E-mail:sales@engineeringsystem.co.jp